

证券代码：688783

证券简称：西安奕材

西安奕斯伟材料科技股份有限公司  
投资者活动记录表

编号：2026-04

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（上市公司新质生产力调研活动）
参与单位名称及参会人员姓名	上海证券报、南方基金、建设银行、中国银行、浦发银行等机构投资者
会议时间	2026年04月29日
会议地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 杨春雷 首席市场官 柳清超 首席品牌官 杨心玮 证券事务代表 赵润欣 财务部 李佳佳 董秘办 索子欣
会议内容	<p>1、请问目前公司 12 英寸硅片在存储芯片和逻辑芯片领域的客户验证进展到了什么阶段？不同技术节点的产品分别对应哪些具体的应用场景？</p> <p>答：公司专注于 12 英寸硅片的研发、制造和生产，产品广泛应用于消费电子、汽车制造、AI 等领域所需要的存储芯片、逻辑芯片、图像传感器、显示驱动芯片、电源管理芯片及 IGBT、Power MOSFET 等功率器件领域。从下游用途来看，可进一步分为用于芯片制造的正片、用于芯片制造设备调试和检测的测试片。其中，正片分为抛光片、外延片。公司当前主要布局用于存储芯片和逻辑芯片制造的抛光片和外延片，该等产品系市场主流，约占 12 英寸硅片市场 75%份额，正在开拓布局细分市场领域。</p> <p>公司系国内头部存储芯片厂商全球 12 英寸硅片厂商中供货量第一或第二大的供应商、国内头部晶圆代工厂中国大陆 12 英寸硅片供应商中供货量第一或第二大的供应商。公司在立足国内市场的同时，持续服务全球客户，已向海外客户如：台积电、美光科技、铠侠、格罗方德、力积电、联华电子、华邦、南亚科等稳定批量供货并不断进行新产品验证，并于 2025 年首次实现三星电子、东芝少批量测试片供货，正在推动其正片认证工作。</p>

**2、请问二期产能如果按照计划在 2026 年底达到满产，届时规模效应体现之后，公司的盈亏平衡大致会在什么时间点实现？**

答：公司第二工厂预计于 2026 年底达产，随着产能充分释放、良率及产品结构持续优化，规模效应将充分凸显，单位固定成本进一步摊薄，整体毛利率稳步修复。基于目前的市场需求、产能爬坡节奏、客户导入进度与产品结构规划，公司预计 2027 年实现合并报表层面盈利。

**3、请问公司在硅片领域的优势和壁垒是什么？**

答：半导体硅片是芯片制造的核心基础材料，广泛应用于集成电路、分立器件、传感器等半导体产品制造。该行业进入壁垒高，具有技术密集、资本密集、研发周期长、客户认证严苛等显著特征。半导体技术向先进制程持续演进，对硅片材料的单晶品质、缺陷密度、几何精度等指标提出更严苛要求。

作为市场主流的 12 英寸硅片，技术发展聚焦于缺陷控制、表面平坦度及局部平整度等关键指标，以满足先进存储芯片及高端逻辑芯片的制造需求。这些关键技术的突破与稳定量产能力，是决定产品性能与良率的核心，也构成了行业内企业最主要的竞争壁垒。此外，具备一定体量规模也是服务全球客户的重要门槛之一。

公司在持续进行扩产的同时，持续进行研发投入，提升技术能力及品质管控能力。截至 2025 年 12 月，公司已布局两个基地、三座现代化智能工厂，产能超过 85 万片/月，位居国内头部，预计 2026 年底第二工厂达产后，公司将具备约 120 万片/月产能，第三工厂预计 2026 年四季度可实现首批设备搬入，2027 年上半年实现首批产能投产，预计 2030 年第三工厂达产后，公司总产能将提升至约 180 万片/月以上，全球市占率将达到约 13%，有望跻身全球前三。此外，公司高度重视夯实技术根基，2022 年至 2025 年公司研发投入占收入比例持续保持 10%以上。